

高速通信向け銅張積層板 エスパネックス / ESPANEX[®] (次世代低誘電CCL)

開発品

低誘電グレード

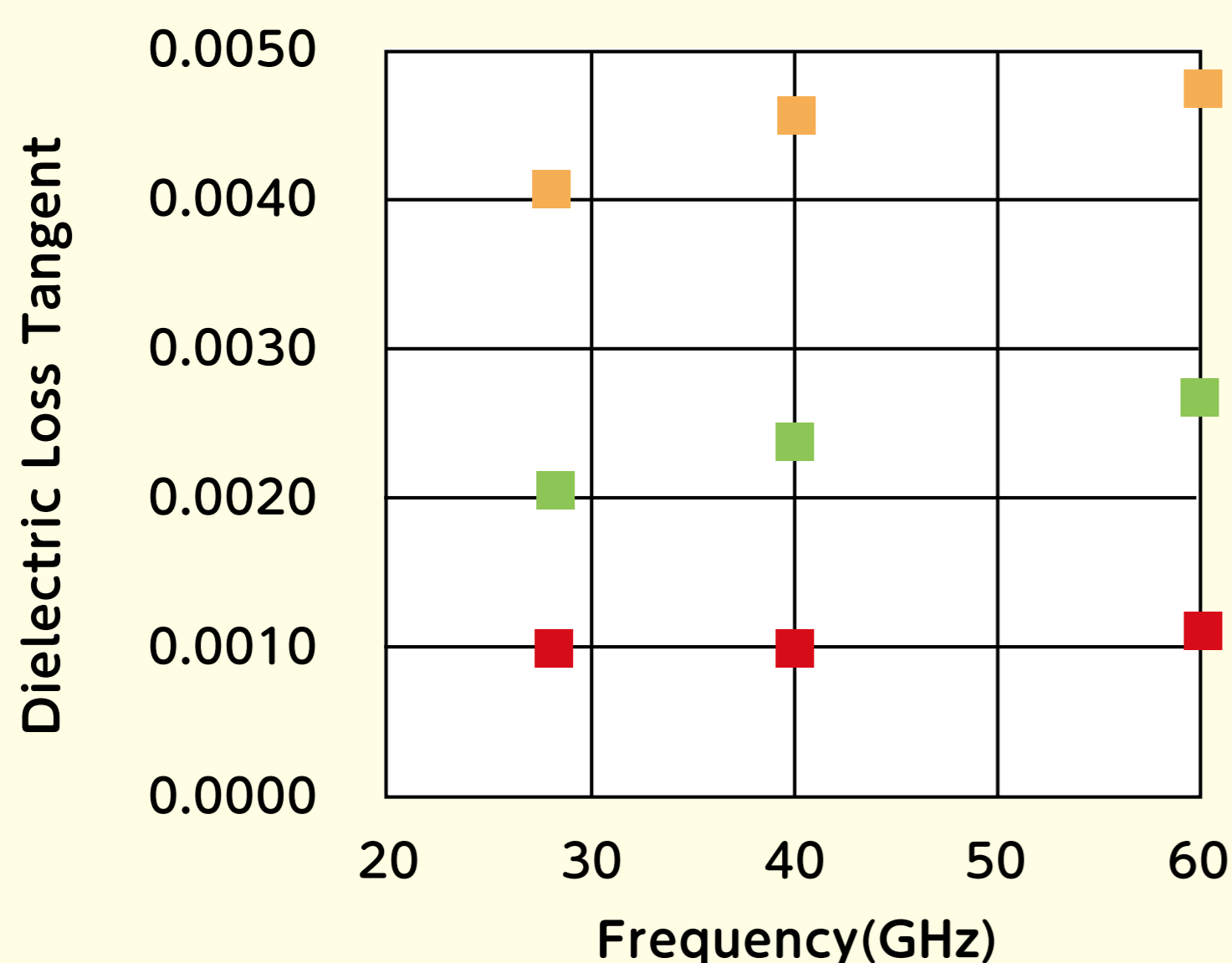
特長

- ▶ 高周波帯域において、低誘電特性を示す。
 - ▶ 低粗度銅箔に対し、高い接着力を発現する。
- ⇒ 5G ミリ波での高速通信において、フッ素樹脂基板と同等の低伝送損失を実現。

一般特性 (プロトタイプ)

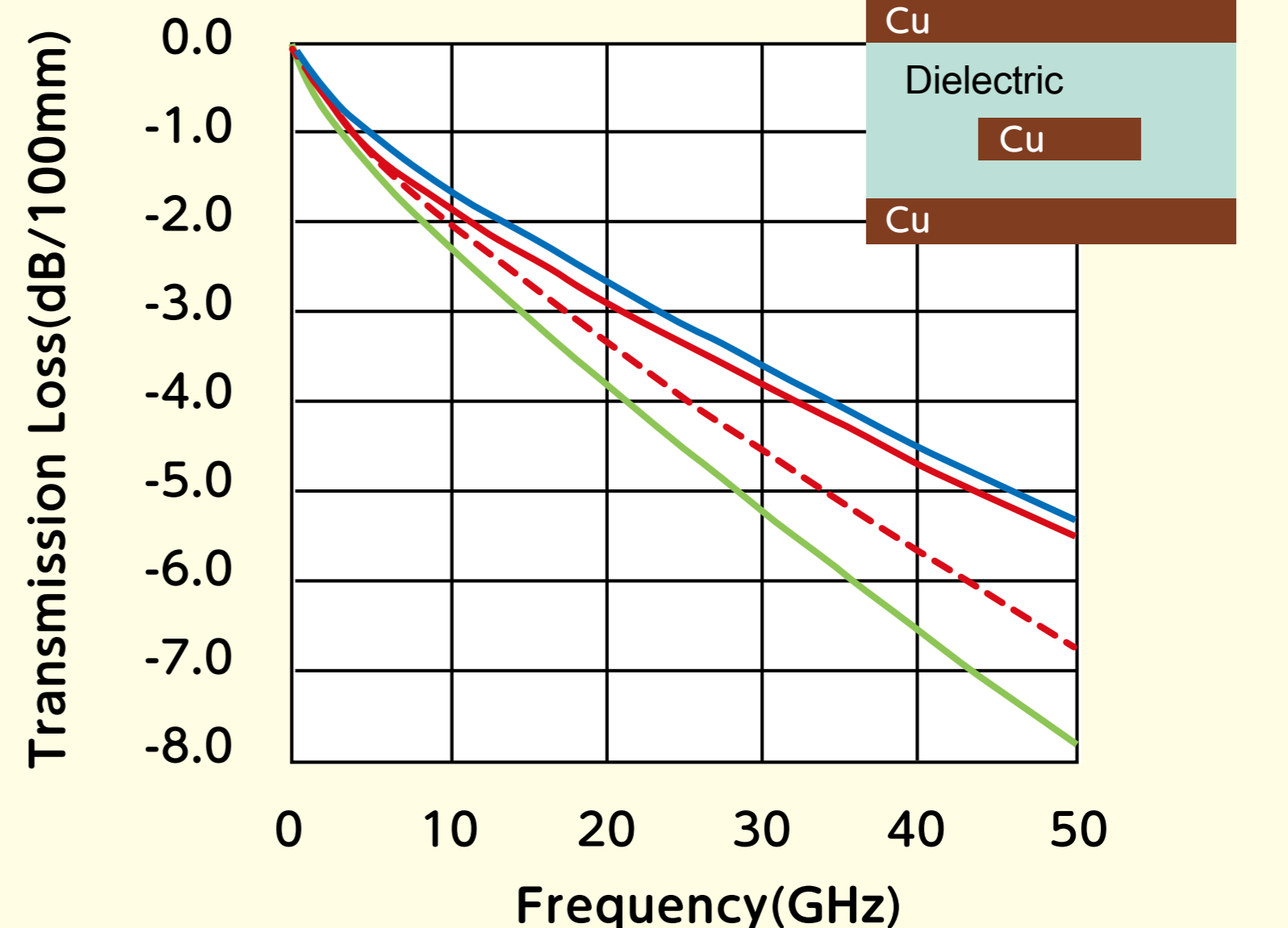
Properties (Prototype)		
Dielectric Constant [X-Y(面方向)]	28GHz	2.8
	40GHz	2.8
	60GHz	2.8
Dielectric Loss Tangent [X-Y(面方向)]	28GHz	0.0010
	40GHz	0.0010
	60GHz	0.0011
Peel Strength [kN/m]		1.0
Water Absorption [wt%]		≤ 0.1
Solder Heat Proof		288°C Pass

誘電特性



- 次世代低誘電 CCL
- MPI (Modified polyimide)-CCL
- LCP (Liquid crystal polymer)-CCL[※]
[[※]refer to catalogue value]

伝送特性 (シミュレーション)



- 次世代低誘電 CCL (Low Profile Copper)
- - - 次世代低誘電 CCL (Conventional Copper)
- フッ素樹脂 CCL (Conventional Copper)
- LCP-CCL (Conventional Copper)